DERWENT-ACC-NO:

1998-316120

DERWENT-WEEK:

199829

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

Resin moulding device, used for

resin moulding lead

frames - has release film conveying

mechanism supplying

release films to a mould by sending

intermittently long

release films from one side to the

other side, and a

quide mechanism

PATENT-ASSIGNEE: APIC YAMADA CORP[APICN]

PAGES

PRIORITY-DATA: 1996JP-0272170 (October 15, 1996)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO

PUB-DATE

LANGUAGE JP 10113946 A MAIN-IPC

May 6, 1998

N/A

800

B29C 045/02

N/A

APPLICATION-DATA:

PUB-NO

APPL-DESCRIPTOR

APPL-NO

JP 10113946A

1996JP-0272170

APPL-DATE

October 15, 1996

INT-CL (IPC): B29C033/68, B29C045/02, B29C045/14,

B29C045/26 ,

B29L031:34 , H01L021/56 B29K105:20 ,

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 10113946A

BASIC-ABSTRACT:

In a resin moulding device using release films, there are provided a release

film conveying mechanism and a guide mechanism. The release film conveying

mechanism (34a,34b,36a,36b) supplies release films

(20a,20b) to a mould by sending intermittently long release films (20a,20b) from one side to the other side of the mould passing the resin moulding surface of the mould, and conveys the moulded part (62) to the release film recovery side in a condition where the outside surface of the moulded part (62) after resin moulding is wrapped in release films. The guide mechanism (42,50) provided on the release film recovery side separates the release films from the moulded part (62) by conveying the release films (20a,20b) in the separating directions.

USE - Used in the resin moulding of lead frames, etc. using release films.

ADVANTAGE - The release films can be easily separated from moulded parts.

Further, the supply operation of release films and the removal operation of moulded parts can be made easily.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.1/7

TITLE-TERMS: RESIN MOULD DEVICE RESIN MOULD LEAD FRAME
RELEASE FILM CONVEY
MECHANISM SUPPLY RELEASE FILM MOULD SEND
INTERMITTENT LONG RELEASE
FILM ONE SIDE SIDE GUIDE MECHANISM

DERWENT-CLASS: A32 A85 L03 U11

CPI-CODES: A11-B01; A11-C06; A12-E07C; A12-W02; L04-C20C; L04-C20D;

EPI-CODES: U11-E02A1:

ENHANCED-POLYMER-INDEXING:
Polymer Index [1.1]
 018 ; P0000 ; S9999 S1285*R
Polymer Index [1.2]
 018 ; ND05 ; Q9999 Q7476 Q7330 ; N9999 N7170 N7023 ;
J9999 J2915*R
 ; N9999 N6359 N6337 ; N9999 N6348 N6337
Polymer Index [1.3]

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C1998-097673 Non-CPI Secondary Accession Numbers: N1998-247919

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-113946

(43)公開日 平成10年(1998)5月6日

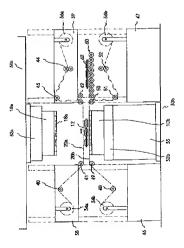
(51) Int.Cl. ⁶		裁別記号		FΙ							
B 2 9 C	45/02			B 2	9 C	45/02					
	33/68					33/68					
	45/14					45/14					
	45/26					45/26					
HO1L	21/56			ΗO	1 L	21/56				T	
			審查請求	未請求	語	寝の数3	OL	(全	8	頁)	最終頁に統
(21)出願番号		特顯平8-272170		(71)出願人 000144821							
							クヤマ				
(22)出顧日		平成8年(1996)10月15日		長野県埴科郡戸倉町大字上徳間90番地							
				(72)	発明:						
						長野県	堆科郡	戸倉	竹大	学上	徳間90番地
						ピック	ヤマダ	株式	会社	内	
				(74)	代理	人 弁理士	綿質	隆。	夫	(外	1名)

(54) 【発明の名称】 リリースフィルムを用いる樹脂モールド装置

(57)【要約】 (修正有)

【課題】 成形品からリリースフィルムを容易に剥離することを可能とし、リリースフィルムの供給操作と成形品の搬出操作を容易に行えるようにする。

【解決手段】 金型の樹脂成形面を通過して金型の一方側から他方側へ長尺体のリリースフィルムを定寸送りすることにより、金型にリリースフィルム20a、20b を供給するとともに、樹脂成形後の成形品62の外面にリリースフィルムの回収側に搬出するリリースフィルムの地送機構34a、34b、36a、36bを設け、該搬送機構のリリースフィルムの回収側に、リリースフィルムを搬送する際に、成形品の両面に被着したリリースフィルム20a、20bが相互に離反する向きに搬送されて成形品62からリリースフィルムを剥離するガイド機構42、50・・を設ける。



「特許請求の範囲」

【請求項1】 上型と下型の各々の樹脂成型面をリリー スフィルムで被覆し、リリースフィルムを介して被成型 品をクランプして樹脂モールドするリリースフィルムを 用いる樹脂モールド装置において、

前記金型の樹脂成形面を通過して金型の一方側から他方 側へ長尺体のリリースフィルムを定寸送りすることによ り、金型にリリースフィルムを供給するとともに、樹脂 成形後の成形品の外面にリリースフィルムが被着した状 態で成形品をリリースフィルムの回収側に搬出するリリ 10 ースフィルムの搬送機構を設け、

該搬送機構のリリースフィルムの回収側に、リリースフ ィルムを搬送する際に、成形品の両面に被着したリリー スフィルムが相互に離反する向きに搬送されて成形品か らリリースフィルムを剥離するガイド機構を設けたこと を特徴とするリリースフィルムを用いる樹脂モールド装

【請求項2】 成形品が搬出される前記金型の回収側の 外部に、リリースフィルムが成形品から徐々に剥離され ることにより回収側に徐々に搬出される成形品を支持す る支持ローラが設けられたことを特徴とする請求項1記 **載のリリースフィルムを用いる樹脂モールド装置。**

【請求項3】 前記リリースフィルムの搬送機構は、リ リースフィルムの搬送時には金型面から離間してリリー スフィルムを支持する支持機構を備えたことを特徴とす る詰求項1または2記載のリリースフィルムを用いる樹 脂モールド装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

用いる樹脂モールド装置に関する。

[0002]

【従来の技術】リリースフィルムを用いる樹脂モールド 方法とはリードフレーム等の被成型品を樹脂モールドす る際に、キャビティの内面等の樹脂が金型にじかに接す る面をリリースフィルムで被覆し、金型面に樹脂を接触 させずに樹脂モールドする方法である。リリースフィル ムはこのように金型の樹脂成型面を被覆するものである から、材質としては所定の耐熱性、柔軟性、樹脂との剥 **解性を有するものが使用される。**

【0003】図4にリリースフィルムを用いる樹脂モー ルド方法を示す。同図で中心線の左半部は樹脂をキャビ ティに充填する前の状態、右半部はキャビティに樹脂を 充填した状態を示す。上型10aと下型10bとで被成 型品12をクランプし、ポット14から樹脂16をキャ ビティ18に充填して樹脂モールドする。20a、20 bはリリースフィルムで、各々上型10aと下型10b のキャビティ凹部の内面形状にならって金型面を被覆し ている

を被覆する方法は、上型10aと下型10bのクランプ 面に吸着孔22を設け、キャビティ凹部の内底面にキャ ビティ吸着孔24を設けて、まず、金型のクランプ面の 吸着孔22からエア吸引してクランプ面に吸着した後、 キャビティ内底面のキャビティ吸着孔24からエア吸着 することによる。リリースフィルム20a、20bは十 分な柔軟性を有しているから、キャビティの内底面から エア吸着することにより、図のようにキャビティの内面 にならって吸着支持される。

【0005】なお、この例ではモールド樹脂として図5 に示すラッピング樹脂26を使用している。 ラッピング 樹脂26はスティック状に固めた樹脂をラッピングフィ ルムで密封したもので、ラッピングフィルムで密封した 状態でポット14に供給する。ポット14内で溶融した 樹脂をプランジャで圧送することにより、ラッピングフ ィルムの両側縁部のシール部分が押し広げられ、キャビ ティ18内に樹脂16が充填される。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】図6は下型10bでの 20 キャビティ凹部、ポット14等の平面配置を示す。ボッ ト14は長孔状に開口し、スティック状に形成したラッ ピング樹脂26が投入できるよう形成されている。リリ ースフィルム20bはキャビティ凹部18aを被覆する 幅で、ポット14を挟む両側に各々配置する。

【0007】リリースフィルム20a、20bを金型面 に吸着支持した後、被成型品12とラッピング樹脂16 をセットし、上型10aと下型10bでクランプして樹 脂封止する。図6に金型によるクランプ部位Aを示す。 金型で被成型品12をクランプする部位は、図のように 【発明の属する技術分野】本発明はリリースフィルムを 30 キャビティ凹部18aの周囲の一定幅の部分とキャビテ ィに樹脂を充填する樹脂路であるランナーおよびゲート が通過する部分である。被成型品12の全面を金型でク ランプしないのは、金型のクランプ力を被成型品12に 有効に作用させ確実にクランプできるようにするためで

> 【0008】図7は被成型品12のリードフレームを金 型でクランプした状態を拡大して示したものである。金 型は被成型品12に有効にクランプ力が作用するように してクランプするのであるが、リリースフィルム20

40 a、20bを介してリードフレームをクランプすると、 リリースフィルム20a、20bは圧縮性が大きいこと からクランプ力によって隣接するリード12 aの中間に リリースフィルム20a、20bがはいり込み、樹脂モ ールド後にリードフレームからリリースフィルム20 a、20bが剥離しにくくなるという問題が生じた。エ ッチングによって製造したリードフレームではリード1 2aの側縁部分がエッジ状に形成されており、またプレ ス加工によって製造したリードフレームではリードの側 面からばりが突出するように形成されているからリード 【0004】リリースフィルム20a、20bで金型面 50 12aの間にはいり込んだリリースフィルム20a、2

0 bがひっかかりやすく、剥離しにくくなる。

【0009】このリードフレームのようにクランプ時に リリースフィルム20a. 20bがリード12aの間に はいり込んでクランプされるようなものの場合は、樹脂 モールド後にリリースフィルム20a、20bを被成型 品12から剥離する操作がスムーズにできず、リリース フィルムの剥離を自動で行うことに支障があったり、無 理にリリースフィルムを剥離するとリードを変形させて しまうといった問題がある。

【0010】本発明はこのように樹脂モールド後の成形 10 品からリリースフィルムが剥離しにくい場合に、リリー スフィルムを確実に剥離することを可能にし、円滑な樹 脂モールド操作を可能にするリリースフィルムを用いる 樹脂モールド装置を提供することを目的としている。 [0011]

【課題を解決するための手段】本発明は上記目的を達成 するため次の構成を備える。すなわち、上型と下型の各 々の樹脂成型面をリリースフィルムで被覆し、リリース フィルムを介して被成型品をクランプして樹脂モールド するリリースフィルムを用いる樹脂モールド装置におい 20 て、前記金型の樹脂成形面を通過して金型の一方側から 他方側へ長尺体のリリースフィルムを定寸送りすること により、金型にリリースフィルムを供給するとともに、 樹脂成形後の成形品の外面にリリースフィルムが被着し た状態で成形品をリリースフィルムの回収側に搬出する リリースフィルムの搬送機構を設け、該搬送機構のリリ ースフィルムの回収側に、リリースフィルムを搬送する 際に、成形品の両面に被着したリリースフィルムが相互 に離反する向きに搬送されて成形品からリリースフィル た、前記成形品が搬出される前記金型の回収側の外部 に、リリースフィルムが成形品から徐々に剥離されるこ とにより回収側に徐々に搬出される成形品を支持する支 持ローラが設けられたことを特徴とする。また、前記リ リースフィルムの搬送機構は、リリースフィルムの搬送 時には金型面から離間してリリースフィルムを支持する 支持機構を備えたことを特徴とする。

[0012]

【発明の実施の形態】以下、本発明の好適な実施形態に ついて説明する。図1~3は本発明に係るリリースフィ ルムを用いる樹脂モールド装置の構成と本樹脂モールド 装置の作用を説明する正面図である。30 aは上型10 aを支持する固定プラテン、30bは下型10bを支持 する可動プラテンである。上型10aは熱板32aおよ びベースを介して固定プラテン30aに固定され、下型 10bは熱板32bを介してベース33に固定されて支 持される。

【0013】34a、34bは上型10aと下型10b の各々にリリースフィルム20a、20bを供給する供

リリースフィルム20a、20bをリールに巻回し、樹 脂モールド操作ごと定寸送りするよう駆動制御される。 36a. 36bは使用後のリリースフィルム20a、2 Obを同取する同収リールである。回収リール36a、 366も上型用と下型用に別々に設けている。

【0014】図1は型開きして成形品50を金型内から 搬出し、リリースフィルム20a、20bを定寸送りし て金型に被成形品12とモールド樹脂をセットした状態 を示す。リリースフィルム20a、20bを定寸送りす る際は、リリースフィルム20a、20bを上型10a と下型10bの金型面から離間した状態で搬送する。こ の実施形態の樹脂モールド装置では上型側の供給リール 34aと回収リール36aについては型開閉方向に昇降 自在に支持された上リール支持プレート38、39に各 々固定し、上リール支持プレート38、39を昇降させ ることにより上型10 aの金型面に対しリリースフィル A20aを接離させるようにしている。 【0015】40、41、42、43、44はリリース

フィルム20 aの撥送をガイドするガイドローラであ り、ガイドローラ40、41は供給側の上リール支持プ レート38に固定され、ガイドローラ42、43、44 は回収側の上リール支持プレート39に固定される。 【0016】下型10bに供給するリリースフィルム2 0 bに対しては、供給リール34 b及び回収リール36

bを型開閉方向に昇降自在に支持された下リール支持プ レート46、47に各々支持するとともに、ガイドロー ラ48、49を供給側の下リール支持プレート46に支 持し、ガイドローラ50、51、52を回収側の下リー ル支持プレート47に支持する。供給リール34b、回 ムを剥離するガイド機構を設けたことを特徴とする。ま 30 収リール36ちは上型側とは異なり、下リール支持プレ ート46、47に対して昇降可能に支持し、ガイドロー ラ48、49およびガイドローラ50、51、52も各 々下リール支持プレート46、47に対して昇降可能に

> 【0017】リリースフィルム20bを供給する際に は、下リール支持プレート46、47が下位置にある状 熊で供給リール34b及び回収リール36bとガイドロ ーラ48、49、50、51、52全体を若干上昇さ せ、リリースフィルム20bを下型10bの金型面から 若干離間させて搬送させる。

【0018】リリースフィルム20a、20bの搬送操 作は上型10aと下型10bの金型面に平行にリリース フィルム20a、20bを搬送し、金型面に平行にリリ ースフィルム20a、20bを接触させてエア吸着によ り金型面にリリースフィルム20a、20bを支持する ものである。このため本実施形態では上リール支持プレ ート38、39および下リール支持プレート46、47 をともに供給側と回収側で高さ位置を一致させて昇降駆 動するようにしている。また、本実施形態では供給側の 給リールである。供給リール34a、34bは長尺状の 50 上リール支持プレート38、39と下リール支持プレー

支持する。

ト46.47は一定間隔を維持して連結されており、可 動プラテン30bとともに下リール支持プレート46、 47が昇降駆動され、これとともに上リール支持プレー ト38 39が昇降する。

【0019】図1では、下型10bの金型面にリリース フィルム20bが吸着支持され、上型10aについては リリースフィルム20aが上型10aの金型面から雑間 して支持されている。下型10bを挟んで下リール支持 プレート46、47に支持したガイドローラ49、50 は下型10bを挟む両側でリリースフィルム20bを金 10 型面位置に合わせて張るようにして支持する位置にあ

【0020】回収側の上リール支持プレート39に設け るガイドローラ42、43および下リール支持プレート 47に設けるガイドローラ50、51は金型からリリー スフィルム20a、20bを排出する排出位置でそれぞ れリリースフィルム20a、20bの排出方向を上下に 振り分けて開く方向にガイドするように配置することが 特徴である。すなわち、回収側への入口部分でガイドロ ーラ42、43は金型面でのリリースフィルム20aの 20 搬送方向とは略直角上向きにリリースフィルム20 aを 導き、ガイドローラ50、51はリリースフィルム20 bを略直角下向きに導く配置としている。

【0021】ガイドローラ44、52は一対のローラで リリースフィルム20a、20bを挟圧する構成とする ことにより、リリースフィルム20a、20bがエンボ ス状等に変形した場合でも、リリースフィルム20a、 20bを平らに修整して回収リール36a、36bに巻 き取ることができるようにしている。

【0022】60は樹脂モールド後の成形品62を取り 出すための支持ローラである。支持ローラ60は型開き 時の下型10bの金型面とローラの上面の高さ位置を略 同一にして複数のローラを並列に設置しものである。支 持ローラ60は金型から送出された成形品60をガイド 支持する作用をなす。

【0023】図1では下型10bにリリースフィルム2 Obを吸着支持した後、被成形品12を下型10bにセ ットしている。この場合の被成形品12のセット方法は とくに限定されるものではない。たとえば、型開き状態 でリリースフィルム20a、20bの搬送方向とは直交 40 する方向から金型内に搬送ヘッドを進入させ、搬送ヘッ ドから被成形品を供給する方法も可能であり、リリース フィルム20a.20bの搬送方向と同方向(図の左方 向)から搬送ヘッドを金型内に進入させて搬送ヘッドか ら被成形品12を供給する方法も可能である。なお、被 成形品12の供給とともにモールド用の樹脂(ラッピン グ樹脂)をボットに供給する。

【0024】被成形品12及びモールド用の樹脂を下型 10bに供給した後、型締めして樹脂成形する。図2は ら可動プラテン30bを上動させると、上リール支持プ レート38、39と下リール支持プレート46、47が ともに上昇駆動される。上リール支持プレート38、3 9と下リール支持プレート46、47は上型10aの金 型面にリリースフィルム20aが接する位置まで上昇し て停止する、ト型10aの金型面にリリースフィルム2 Oaが接した状態で金型面にリリースフィルム20aを エア吸着し、キャビティ凹部18の内面等の金型面をリ リースフィルム20aで被覆する。

【0025】次に、上リール支持プレート38、39お よび下リール支持プレート46、47を停止したまま、 下型10bをさらに上動させ、型締め工程に進む。この 型締め工程では下リール支持プレート46、47に支持 した供給リール34bおよび回収リール36bと、ガイ ドローラ48、49、50、51、62を下リール支持 プレート46、47に対して上昇させリリースフィルム 20a、20bを介した被成形品12の型締めがスムー ズになされるようにする。図2に示すように、彼成形品 12を型締めし、キャビティ内に樹脂を充填して樹脂成 形する。

【0026】樹脂が硬化した後、型開きし、成形品62 の取り出し操作に進む。型開き時には下リール支持プレ ート46、47に対して供給リール34bおよび回収リ ール36bを上位置にしたまま可動プラテン30bを下 降させる。図3は可動プラテン30bが下位置まで降下 1. か状態である。可動プラテン30bが下降することに より上リール支持プレート38、39と下リール支持プ レート46.47もともに下位置まで下降する。

【0027】成形品62は型開きとともに上リール支持 プレート38、39が下降することにより上型10aの 金型面から離間しリリースフィルム20aにより表面が 被覆された状態で下降する。なお、リリースフィルム2 0a、20bは金型との剥離性が良好なフィルム材によ って形成するから、型開きによって容易に上型10aか らリリースフィルム20aは剥離するが、剥離しにくい 場合には、エア吸着で使用したエア流路から逆にエアを 叶出させて離型させることもできる。

【0028】型開きが進むとともに、成形品62はリリ ースフィルム20a、20bによって外面が被覆された

状態で下型10bに載ったまま下降する。そして、下型 10bが最下位置に下降する際に、下型10bから剥離 して図3に示すようにリリースフィルム20a、20b で吊持されるようになる。下リール支持プレート46、 47で供給リール34b及び回収リール36bを上位置 に設定しているのは、下型10bが最下位置まで下降し た際にリリースフィルム206の高さ位置が下型106 の金型面よりも若干上位置になるようにするためであ

【0029】下型10bから成形品62が離間した状態 型締めして樹脂成形している状態である。図1の状態か 50 で供給リール34a、34bおよび回収リール36a、

366を回転駆動し、金型外の支持ローラ60を配置し た側に被成形品62を移送する。リリースフィルム20 a、20bが成形品62に付着していることにより、リ リースフィルム20a、20bを搬送することによって 成形品62が先送りされる。

【0030】そして、金型外の支持ローラ60への入口

部分まで成形品62が進むと、前述したガイドローラ4 2.43、50、51の配置によりリリースフィルム2 0aとリリースフィルム20bが上方と下方に振り分け るように引き離され、リリースフィルム20a、20b 10 を搬送することによる引っ張り力によって成形品62の 表面からリリースフィルム20a、20bが剥離され、 成形品62のみが支持ローラ60上に押し出され、リリ ースフィルム20a、20bは上型側の回収リール36 aと下型側の回収リール36bに各々巻き取られる。 【0031】リリースフィルム20a、20bの搬送操 作は成形品62を支持ローラ60上まで排出するととも に、金型上に新たにリリースフィルム20a、20bを 供給するための操作であり、所定長さ分だけリリースフ 62の搬出とリリースフィルム20a、20bの供給操 作が同時になされる。

【0032】成形品62の搬出とリリースフィルム20 a. 20bの定寸送りが完了した後、下リール支持プレ ート46、47に支持した供給リール34b及び回収リ ール36b、ガイドローラ48、49、50、51、5 2を下位置まで下降させ、リリースフィルム20bを下 型10bの金型面に接触させ、下型10bにリリースフ ィルム20bをエア吸着して支持する。図1はこの状態 で被成形品12を下型10bにセットした状態である。 【0033】本実施形態の樹脂モールド装置によれは、 以上のようにして、リリースフィルム20a、20bと 被成形品12の供給操作、および成形品62に付着した リリースフィルム20a、20bの剥離および成形品6 2の搬出操作をすべて自動で行うことができる。 本実施 形態では成形品62の外面にリリースフィルム20 a、 20bが付着していても、成形品62の両面から同時に リリースフィルム20a、20bを物理的に引き剥がす ようにして剥離するから、成形品62から確実にリリー スフィルム20a 20bを剥離することができるとい 40 う特徴がある。本方法によれば、リードフレームのリー ド間にリリースフィルムがくい込んでいるような場合で も確実にリリースフィルムを剥離することが可能であ

【0034】なお、以上説明した実施形態では、上リー ル支持プレート38、39と下リール支持プレート4 6、47が一定間隔を維持して連動するように構成した が、上リール支持プレート38、39と下リール支持プ レート46、47を別駆動する構成とすることももちろ ん可能である。また、上リール支持プレート38、39 50 60 支持プレート

と下リール支持プレート46、47を可動プラテン30 bとは別駆動することも可能である。この場合には、供 給リール34bと回収リール36bを下リール支持プレ ート46 47に対して昇隆可能に設けてリリースフィ ルム20bを金型面に接離させるかわりに下リール支持 プレート46、47を昇降させてリリースフィルム20 bの位置を調節することが可能である。このように、リ リースフィルム20a、20bの搬送方法等が上記実施 形態に限定されるものではもちろんない。

[0035]

【発明の効果】本発明に係るリリースフィルムを用いる 樹脂モールド装置によれば、上述したように、リリース フィルムを用いて樹脂モールドした際に成型品からリリ ースフィルムが剥離しにくい場合であっても確実にリリ ースフィルムを剥離してリリースフィルムの供給操作と 成形品の取り出し操作を確実に行うことが可能になる等 の著効を奏する。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係るリリースフィルムを用いる樹脂モ ィルム20a、20bを搬送することによって、成形品 20 ールド装置で被成形品をセットした状態を示す正面図で

> 【図2】本発明に係るリリースフィルムを用いる樹脂モ ールド装置で型締めした状態を示す正面図である。

> 「図3】本発明に係るリリースフィルムを用いる樹脂モ ールド装置で型開き後、成形品を取り出す状態を示す正 面図である

> 【図4】リリースフィルムを用いる樹脂モールド方法を 示す説明図である。

【図5】ラッピング樹脂の斜視図である。

【図6】金型により被成型品をクランプする部位を示す 説明図である。

【図7】リリースフィルムがリード間にくい込む様子を 示す説明図である。

【符号の説明】

10a 上型

10b 下型

12 被成型品

14 ポット

20a、20b リリースフィルム

26 ラッピング樹脂

30a 固定プラテン

306 可動プラテン

32a. 32b 熱板

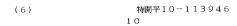
34a. 34b 供給リール 36a、36b 回収リール

38、39 上リール支持プレート

40、41、42、43、44 ガイドローラ

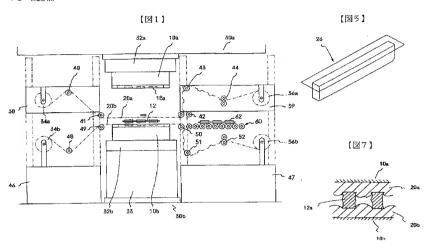
48、49、50、51、52 ガイドローラ

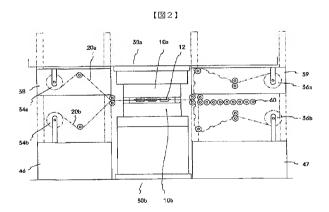
46、47 下リール支持プレート



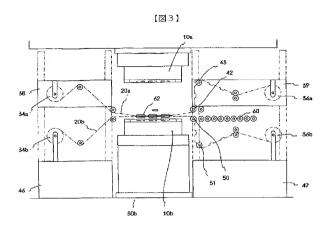
62 成形品

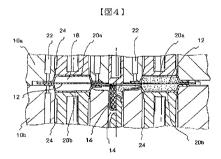
9





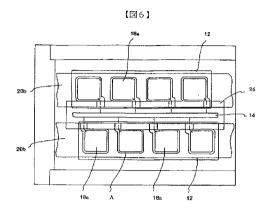
11/13/2003, EAST Version: 1.4.1





(8)

特開平10-113946



フロントページの続き

(51)Int.Cl.⁶ // B 2 9 K 105:20

B29K 105:20 B29L 31:34 識別記号 FI